LAGENAUFBAU HDI (Standard)

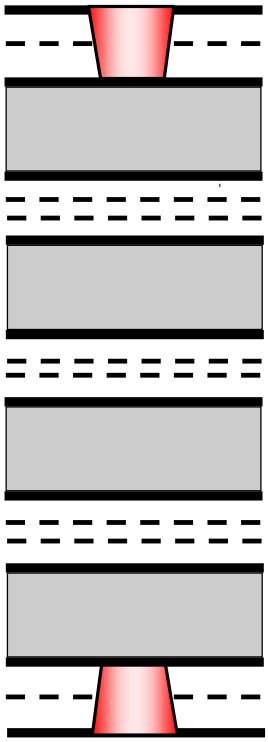
HDI10_1+8+1_1,60_35

10 - Lagen

Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 8 + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	2			35 µm		**33**	
			0,200 mm			**200**	
3	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
4	4			35 µm		**33**	
			0,200 mm			**200**	
5	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
6	6			35 µm		**33**	
			0,200 mm			**200**	
7	7			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
8	8			35 µm		**33**	
			0,200 mm			**200**	
9	9			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	
						Gesamtdicke Material:	1580

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,60**	+/-	0,13	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,69	+/-	0,16	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,75	+/-	0,18	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	1+